



2024年4月19日

各 位

会社名 新光電気工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 倉嶋 進
コード番号 6967 東証プライム市場
問合せ先 経営企画室長 清野 貴博
TEL(026) 283-1000 (代)

当社の親会社 富士通株式会社
代表者名 代表取締役社長 時田 隆仁
コード番号 6702 東証プライム市場

業績予想の修正に関するお知らせ

業績予想の修正につき、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 2024年3月期通期連結業績予想数値の修正（2023年4月1日～2024年3月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想 (A)	230,000	35,000	35,000	24,000	177.63
今回修正予想 (B)	209,900	24,800	27,200	18,600	137.66
増減額 (B-A)	△20,100	△10,200	△7,800	△5,400	—
増減率 (%)	△8.7	△29.1	△22.3	△22.5	—
(ご参考) 前期実績 (2023年3月期)	286,358	76,712	78,755	54,488	403.32

2. 修正の理由

半導体市場は、緩やかな需要回復が見られるものの、世界的なインフレの継続、米国による対半導体輸出規制の影響ならびにパソコン、サーバー、スマートフォン向け需要の低迷や在庫調整の長期化などにより、市況回復が遅れ、第4四半期においても厳しい環境が継続しました。

このような状況下において、当社グループにおきましては、市況低迷長期化の影響を大きく受け、各製品の売上は想定に比べ総じて下回って推移いたしました。

フリップチップタイプパッケージにつきましては、パソコンやサーバー向けの需要低迷が想定より長期化していることなどの影響を大きく受けました。また、半導体製造装置向けセラミック静電チャックは、半導体輸出規制等を背景として受注が減少したことに加え、リードフレームは半導体市況低迷による在庫調整継続の影響を受け、プラスチックBGA基板は先端メモリー向け需要が減少するなど、売上高は想定を下回る見込みとなりました。利益面につきましても、売上高の減少などにより想定を下回る見込みとなりました。

このような状況をふまえ、2023年10月20日に発表いたしました2024年3月期通期の連結業績予想数値を修正いたします。

※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。

実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

以 上